

2024-2030年中国LED衬底行业发展趋势与发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国LED衬底行业发展趋势与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202408/467147.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

目前有部分LED芯片采用硅衬底。硅衬底的芯片电极可采用两种接触方式，分别是L接触（Lateral-contact,水平接触）和V接触（Vertical-contact,垂直接触），以下简称为L型电极和V型电极。通过这两种接触方式，LED芯片内部的电流可以是横向流动的，也可以是纵向流动的。由于电流可以纵向流动，因此增大了LED的发光面积，从而提高了LED的出光效率。因为硅是热的良导体，所以器件的导热性能可以明显改善，从而延长了器件的寿命。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国LED衬底行业发展趋势与发展趋势研究报告》共五章。首先介绍了中国LED衬底行业市场发展环境、LED衬底整体运行态势等，接着分析了中国LED衬底行业市场运行的现状，然后介绍了LED衬底市场竞争格局。随后，报告对LED衬底做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国LED衬底行业发展趋势与投资预测。您若想对LED衬底产业有个系统的了解或者想投资中国LED衬底行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 LED衬底行业相关基础概述

1.1 LED衬底的定义及分类

1.1.1 LED衬底的界定

1.1.2 LED衬底的分类

1.1.3 LED衬底的特性

1.2 LED衬底行业特点分析

1.2.1 市场特点分析

1.2.2 行业经济特性

1.2.3 行业发展周期分析

1.2.4 行业进入风险

1.2.5 行业成熟度分析

第2章：LED衬底、外延片及芯片市场发展环境分析

2.1LED行业管理规范

2.1.1管理体制

2.1.2发展政策及法规

2.1.3相关标准

2.1.4发展规划

2.2国内外宏观经济走势分析

2.2.1国外宏观经济走势分析

2.2.2国内宏观经济走势分析

2.2.3宏观经济对行业的影响

2.3社会节能及照明环境分析

2.4LED衬底、外延片及芯片技术发展分析

2.4.1LED衬底专利分析

(1) 专利数量分析

(2) 专利申请人分析

2.4.2LED外延片专利分析

(1) 专利数量分析

(2) 专利申请人分析

2.4.3LED芯片专利分析

(1) 专利数量分析

(2) 专利申请人分析

第3章：LED衬底、外延片及芯片产业链分析

3.1LED产业链结构及价值环节

3.1.1LED产业链结构简介

3.1.2LED产业链价值环节

3.1.3LED产业链投资情况

3.1.4LED产业链竞争格局

3.2LED外延发光材料的选择

3.2.1LED发光技术的基础

3.2.2半导体能带特征和外延材料选择

(1) 可见光波长与外延半导体禁带宽度的关系

(2) 直接跃迁与间接跃迁

(3) 外延材料选择

3.3 LED衬底的选择

3.3.1 LED衬底的选择要求

3.3.2 四元系红黄光LED的衬底选择

(1) GaAs晶体的不可替代性

(2) GaAs衬底制造的竞争情况

3.3.3 蓝绿光LED衬底的选择

(1) 选择蓝宝石衬底的可行性

(2) 蓝宝石衬底的缺陷和改进方法

(3) 蓝宝石衬底制造的竞争情况

(4) 蓝宝石衬底新增投资及产能

(5) 蓝绿光LED衬底的其他选择

第4章：LED衬底、外延片及芯片市场发展前景分析

4.1 LED芯片市场分析

4.1.1 LED芯片行业总产值分析

4.1.2 LED芯片制造成本分析

4.1.3 LED芯片市场价格分析

4.1.4 LED芯片指数

4.1.5 LED芯片细分产品市场分析

(1) GaN LED芯片市场分析

(2) 四元LED芯片市场分析

(3) 普亮LED芯片市场分析

4.1.6 LED芯片企业发展分析

(1) LED芯片企业总体数量

(2) LED芯片企业区域分布

(3) LED芯片企业产量情况

4.1.7 LED芯片产值区域分布

4.1.8 LED芯片行业市场发展前景

4.2 LED外延片市场分析

4.2.1 外延片市场规模分析

4.2.2 外延片制造成本分析

4.2.3外延片需求结构分析

4.2.4外延片发展前景分析

4.3LED蓝宝石衬底市场分析

4.3.1蓝宝石衬底市场规模分析

4.3.2蓝宝石衬底制造的竞争情况

4.3.3蓝宝石衬底新增投资及产能

4.3.4蓝宝石衬底价格走势分析

第5章：LED衬底、外延片及芯片企业经营情况分析

5.1LED衬底、外延片及芯片企业经营情况概述

5.2LED衬底、外延片及芯片企业经营分析

5.2.1天通控股股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 主要经济指标分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

5.2.2深圳市聚飞光电股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 主要经济指标分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

5.2.3三安光电股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 主要经济指标分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

5.2.4江西联创光电科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 主要经济指标分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

5.2.5杭州士兰微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 主要经济指标分析
- (3) 企业盈利能力分析
- (4) 企业运营能力分析

图表目录：

图表：LED芯片相关专利申请人构成（单位：个）

图表：LED产业链结构图（一）

图表：LED产业链结构图（二）

图表：LED产业链价值曲线图（单位：%）

图表：LED产业链各环节代表性企业

图表：半导体材料特性比较（单位： ， g/cm³）

图表：GaAs与InP、GaP、AlP的晶格匹配（单位：nm）

图表：低阻GaAs衬底制造厂商的市场占有率分布（单位：%）

图表：GaN蓝绿光LED衬底选择之比较（单位： ， 元）

图表：使用蓝宝石和SiC衬底的LED芯片结构对比

图表：使用蓝宝石和SiC衬底的LED芯片结构对比

图表：蓝宝石晶棒生产企业市场占有率（单位：%）

图表：蓝宝石衬底市场占有率（单位：%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202408/467147.html>